证券代码：300456　　证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-007

投资者关系活动类别	■特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	CGS-CIMB Securities(USA),Inc　Yuwei Cao Raymond James　Peter Vogel Lazard Asset Management　Robert Horton Principal Global Investors　Rijo Oommen Boston Partners　John Zhao Wasatch Advisors　Pedro Huerta
时间	2022 年 2 月 15 日上午 8:30-9:30
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌 副总经理、证券事务代表：刘波 证券事务专员：孙玉华 证券事务助理：刘妍君
投资者关系活动主要内容介绍	上市公司解答提问，主要提问及解答如下： **1、请问公司 MEMS 及 GaN 目前的业务结构如何？瑞典 FAB1&2 的运营情况？北京 FAB3 是否成功从瑞典转移了技术 IP？GaN 业务处于业务扩张阶段还是仍处于研发阶段？是否仍面临供应链短缺的问题？** 答：公司 MEMS 主要面向通信、生物医疗、工业汽车及消费电

	子几大领域，业务结构取决于客户代工需求；GaN 包括外延材料及芯片设计两块业务。近年来，瑞典 FAB1&2 持续扩产，业务保持增长，盈利能力良好。北京 FAB3 此前在瑞典 FAB1&2 的支持协助下完成建设及前期准备，目前已具备独立运营能力。公司 GaN 业务既存在成熟产品，同时也在研发新的品类，公司一直在努力解决 GaN 业务的供应问题，包括与境内外代工厂商进行合作，同时正通过一家参股子公司加紧建设制造产能，其中设备已基本到位，正在建设厂房等基础设施。 **2、请问公司 MEMS 工艺开发涉及哪些产品？主要面向哪一类型的客户？是否存在区域划分？瑞典 FAB1&2 在通信和生物医疗领域有哪些客户？** 答：对于瑞典工厂和北京工厂，我们的 NRE 服务面向全球，开发哪种产品完全取决于客户需求。公司不存在主动区域划分的动机，我们的工厂欢迎全球客户，也希望全球贸易环境能够尽快恢复。但为适应当前和未来复杂的国际环境，公司正在努力建立中国境内和中国境外两套业务循环系统，即境内外均能够为客户提供工艺开发及晶圆制造服务。与其他领域一样，公司在通信和生物医疗领域的客户同时包括知名大型公司或新兴初创企业，但受协议条款限制，除非客户自愿公布，我们不能主动披露客户的具体信息。 **3、请问北京 FAB3 当前的运营及产能利用率情况？产能计划如何？其技术能力与良率与瑞典 FAB1&2 相比如何？北京 FAB3 已有哪些客户？产品是否已包括硅麦克风、压力传感器、硅扬声器？** 答：北京 FAB3 截至目前的运营符合我们的预期，产能利用率从零开始逐步爬升，产能正在持续扩充过程中，技术能力正在不断积累。由于定位是量产工厂，同时也有来自客户的要求，

	北京 FAB3 部分产品的良率高于瑞典工厂。除部分客户如深圳通用微、武汉敏声主动宣布外，北京 FAB3 同样不能透露其他大小客户的具体名称。北京 FAB3 正在努力覆盖通信、生物医疗、工业汽车及消费电子等业务领域，涉及硅麦克风、电子烟开关、惯性传感器、BAW 滤波器、激光雷达、微流控器件等，当然相关业务和产品取决于客户、处于不同阶段，仍需要更多的时间积累。 **4、请问公司 MEMS 业务增长有哪些驱动因素？是否包括中国市场因素？是否包括生物医疗的电容式微机械超声传感器？是否包括红外热成像、激光雷达市场？** 答：包括了提问中所提到的这些驱动因素，订单来自于全球客户，最终来自于各类终端应用场景传导的硬件需求。 **5、请问公司服务的客户中，是否其中一些同时也拥有自己的 FAB 工厂？** 答：公司 MEMS 业务主要服务于 Fabless（无晶圆厂）、Fablite（轻晶圆厂）模式下运营的客户，当然有时候也会有 IDM 模式下运营的客户，公司与此类客户往往不存在代工业务冲突。 **6、我们看到，一些分析师预计公司的收入及利润将在 2022 和 2023 年迎来强劲增长，请问主要结构和驱动因素是什么？北京 FAB3 的毛利率相比瑞典 FAB1&2 的情况如何？** 答：分析师报告属于第三方研究成果，并不代表公司意见或实际状况，但我们的确对未来业务有信心，我们预计 MEMS 是增长的主要驱动力，依赖于下游硬件需求的爆发。我们预计量产工厂北京 FAB3 的毛利率水平将低于精品工厂瑞典 FAB1&2，但其依然可以拥有正常的半导体代工的毛利水平。

	7、与终端应用市场的强劲需求相比，公司 2019 和 2020 年的收入及每股收益相对较低，为什么会出现这种情况？ 答：一方面是因为公司在 2019 及 2020 年度仍持有剥离前的导航及航空电子业务；另一方面是因为公司当时正在努力扩大 MEMS 产能，业务潜力尚未得到释放。 **8、请介绍 FAB6、FAB7 的考虑及现状？** 答：如前所述，主要基于建立两套业务循环系统的考虑。FAB6 的定位是 12 英寸量产线，FAB7 的定位是 6/8 英寸中试线。该两条产线尚处于框架协议阶段，尚未正式开始建设，未来均需要客观的建设周期。 **9、MEMS 是一个小众且竞争激烈的市场，这是否也是 TSMC 和 SMIC 尚未投入更多资源的原因？这个市场不仅包括纯代工前五名的 SMEI（Silex）、Teledyne、Sony、TSMC 和 X Fab，还包括 Asia Pacific、IMT、Philips、Vanguard、Tower Jazz、UMC Group、STM、Rohm 等纯代工或 IDM 厂商，还有广州增芯等新兴厂商？请问公司在该市场中是如何定位自身的？** 答：必须承认，MEMS 当前的市场规模仍较为有限，但我们看好其未来的需求爆发潜力。公司不便评价其他厂商，但比较明显的是，公司不足之处在于缺乏大规模生产运营经验，还需要业务及时间的积累；公司的优势在于先进且丰富的制造工艺技术，正在全球范围内努力布局和扩充的产能，我们的定位是全球领先的纯代工厂商，希望能够提前做好迎接市场需求爆发的准备、工艺技术潜力能够得以发挥。 **10、根据公司在 2021 年 12 月签署的协议，公司拟从 Elmos 手中收购一座 8 英寸晶圆厂，公司具体购买的是哪个实体？产能水平如何？该笔交易的背景？Elmos 的汽车芯片涉及哪些**

	类别？该等芯片是直接销售给车厂还是零部件公司？截至目前该笔交易的审批进展如何？ 答：我们计划收购的是 Elmos 公司旗下的芯片制造部门，交易中为此专门设立了一家 SPV 公司承接 FAB5 工厂的相关资产、人员及业务等。该 FAB 的产能水平高于瑞典 Silex，运行状态良好。背景是 Elmos 希望下一步专注于设计业务，而对于赛微而言，一方面可以借此进入基于新能源和智能汽车产业的汽车芯片代工领域，另一方面可以为瑞典 Silex 的 MEMS 业务提供新的产能，有利于满足来自 AR/VR 等领域的业务需求。涉及的汽车芯片应用于汽车安全气囊系统、制动系统、中控显示、内外车灯调节控制、发动机控制、电子电气系统等，芯片销售给汽车部件供应商。截至目前该笔交易仍处于审批过程中，若进展顺利，双方希望能够在今年 6 月底前尽快完成交割。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 15 日